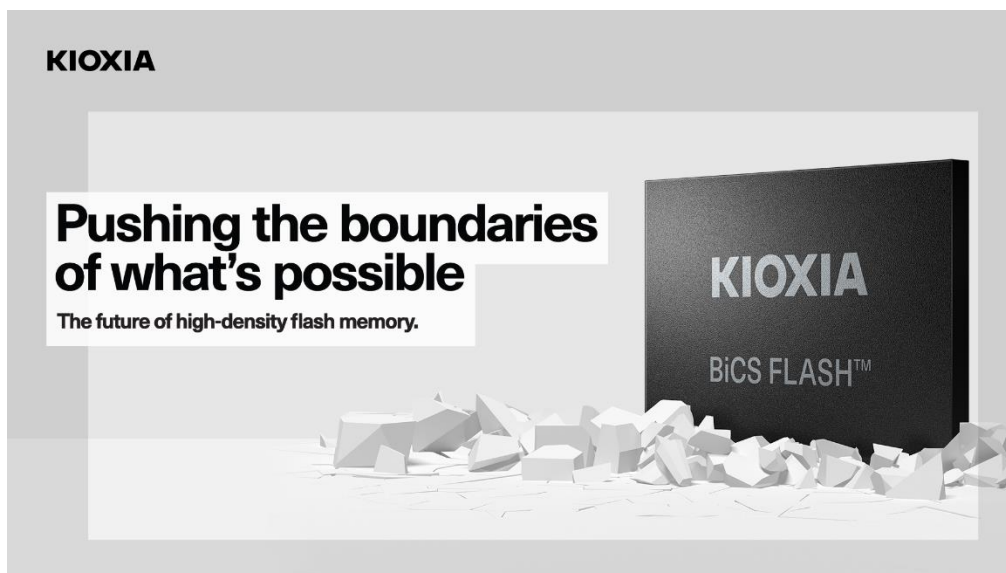


Пресс-релиз

KIOXIA и Western Digital анонсировали новейшую 3D флэш-память

Революционные инновации в архитектуре, в технологиях масштабирования и склеивания плат позволяют сделать значительный рывок в области производительности, плотности и экономической эффективности памяти



Дюссельдорф, Германия, 31 марта 2023 г. – [Компания KIOXIA Europe GmbH](#) презентует новейшие разработки как результат сотрудничества корпораций KIOXIA и Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) Названные компании, находящиеся в постоянном поиске инновационных решений, раскрыли детали разработанной ими новейшей технологии 3D флэш-памяти. Созданная на базе передовых технологий масштабирования и склеивания плат 3D флэш-память обеспечивает исключительную емкость, производительность и надежность по адекватной цене, в результате ее применение идеально удовлетворяет потребности пользователей с учетом экспоненциального роста объема данных в широком диапазоне сегментов рынка.



«Новая 3D флэш-память демонстрирует преимущества нашего тесного взаимодействия с KIOXIA и ведущих позиций наших компаний в области инноваций, — сказал Альпер Илкбахар, старший вице-президент по технологическому и стратегическому развитию компании Western Digital.

— Работая по единой концепции в области исследований и разработок и продолжая инвестировать в эту область, мы смогли выпустить на рынок эту фундаментальную технологию раньше, чем планировалось, и нам удалось найти высокопроизводительные и экономичные решения».

Компании KIOXIA и Western Digital сократили стоимость благодаря внедрению ряда не имеющих аналогов процессов и архитектурных решений, что дало возможность дальнейшему развитию горизонтального масштабирования. Подобный баланс между вертикальным и горизонтальным масштабированием обеспечивает большую емкость для кристалла меньшего размера с меньшим количеством слоев с учетом оптимизации стоимостного показателя. Благодаря сотрудничеству компаний создана также революционная технология CBA (CMOS directly Bonded to Array / КМОП, напрямую совмещенная с массивом), в которой КМОП-структуры и массивы ячеек находятся на отдельных пластинах с оптимизацией каждого процесса, после чего совмещаются для обеспечения повышенной битовой плотности и высокой скорости ввода-вывода NAND.

«Благодаря нашему уникальному инженерному партнерству мы успешно выпустили восьмое поколение BiCS FLASH™ с самой высокой¹ в отрасли битовой плотностью», — сказал Масаки Момодомо, главный технологический директор корпорации KIOXIA. — Отрадно, что KIOXIA начала поставку единичных изделий отдельным потребителям. Применяя технологию CBA и инновации в области масштабирования, мы расширили наш ассортимент технологий 3D флэш-памяти для применения в составе различных систем обработки данных, включая смартфоны, объекты Интернета Вещей и дата-центры».



218-слойная 3D флэш-память использует трехуровневую (TLC) и четырехуровневую ячейки (QLC) емкостью 1 ТБ с четырьмя плоскостями и поддерживает инновационную технологию боковой компрессии для увеличения битовой плотности более чем на 50 %. Быстрый ввод-вывод NAND со скоростью более 3,2 Гбит/с, что на 60 % лучше по сравнению с предыдущим поколением, в сочетании с улучшенной на 20 % скоростью записи и задержкой чтения, повысит общую производительность и удобство для пользователей.

####

Заявления о перспективах развития компании (примечание для редакторов)

В настоящем пресс-релизе содержатся заявления о перспективах развития компании в понимании федеральных законов о ценных бумагах, в том числе и заявления, касающиеся прогнозов относительно наличия, производства, возможностей, производительности, надежности, эффективности и влияния нашей технологии 3D флэш-памяти следующего поколения и продуктов, использующих нашу технологию 3D флэш-памяти следующего поколения. Названные заявления о перспективах развития компании основываются на текущих ожиданиях руководства и связаны с рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от указанных или предполагаемых в этих заявлениях. К важным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от указанных или предполагаемых в заявлениях о перспективах развития компании, относятся: неустойчивая мировая экономическая конъюнктура; будущие ответные меры на пандемию COVID-19 или другие аналогичные глобальные кризисы в области здравоохранения и их последствия; влияние коммерческой деятельности и рыночных условий; результаты и последствия нашего текущего стратегического обзора, в том числе в отношении взаимоотношений с клиентами и поставщиками, нормативных и договорных ограничений, волатильности цен на акции и отвлечения внимания руководства от текущих деловых операций и возможностей; влияние конкурентоспособных изделий и цен; наша разработка и внедрение продукции на основе новых технологий и выход на новые рынки хранения данных; риски,

связанные с инициативами по снижению затрат, реструктуризацией, приобретениями, отделением активов, слияниями, совместными предприятиями и нашими стратегическими отношениями; сложности или задержки в производстве или другие сбои в цепочке поставок; наем и удержание ключевых сотрудников; наш высокий уровень долговых и других финансовых обязательств; изменения во взаимоотношениях с ключевыми клиентами; сбои в работе из-за кибер-атак или других угроз безопасности системы; действия конкурентов; риски, связанные с соблюдением изменяющихся правовых и нормативных требований и исходом судебных разбирательств; а также другие риски и факторы неопределенности, указанные в документах, которые компания представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), включая Форму 10-K, поданную ею в SEC 25 августа 2022 года, на что мы обращаем ваше внимание. Вам не следует чрезмерно полагаться на указанные заявления о перспективах развития компании, которые действительны только на дату настоящего документа, и компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру этих заявлений для отражения новой информации или событий, за исключением предусмотренных законом случаев.



©2023 Western Digital Corporation или ее дочерние компании. Все права защищены.
Western Digital, дизайн Western Digital и логотип Western Digital являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Western Digital Corporation или ее дочерним компаниям в США и/или других странах. Все иные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

¹Источник: По состоянию на 30 марта 2023 года. Исследование KIOXIA.

О компании KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (ранее Toshiba Memory Europe GmbH) – расположенное в Европе подразделение KIOXIA Corporation, ведущего мирового поставщика флэш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). От изобретения флэш-памяти до современной революционной BiCS FLASH, KIOXIA продолжает разрабатывать передовые решения и услуги в области цифровых устройств хранения данных, которые обогащают жизнь людей и расширяют горизонты общества. Инновационная технология 3D флэш-памяти BiCS FLASH нашей компании формирует будущее систем хранения данных в приложениях с высокой плотностью, включая современные смартфоны, ПК, твердотельные накопители, автомобили и центры обработки данных.

Посетите наш [веб-сайт KIOXIA](#)

Контактные данные для публикации:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (г. Дюссельдорф, Германия)

Тел.: +49 (0)211 368 77-0

Электронная почта: KIE-support@kioxia.com

Контактные данные для редакционных запросов:

Лена Хоффманн, KIOXIA Europe GmbH

Тел.: +49 (0) 211 36877 382

Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com

Опубликовано:

Биргит Шонигер, публицист

Тел.: +49 (0) 4181 968098-13

Электронная почта: birgit.schoeniger@publitek.com